

「SEMICON Japan / APCS 2022」出展のご案内

拝 啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスグループは、12月14日（水）～16日（金）に東京ビッグサイトで開催される

『SEMICON Japan / APCS (Advanced Packaging and Chiplet Summit) 2022』に出展いたします。

芝浦メカトロニクス株式会社は、長年培ってきたコア技術（精密メカトロニクス、洗浄、ボンディング、エッチング、真空、成膜など）を結集して、半導体、フラットパネルディスプレイ、電子部品などの用途向けに製造装置の開発からサービスまでトータルソリューションを提供しています。

芝浦エレテック(株)は「心と技術で未来をつくるサービス会社」として様々な協力会社様と連携し、ワンストップサービスを提供しています。

是非この機会に、芝浦メカトロニクスグループの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げます。

敬 具

- 記 -

日 時 : 2022年12月14日（水）～16日（金） 10:00 ～ 17:00

会 場 : 東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟

展示ブース : ①総合ゾーン 東展示棟 Hall2 小間番号 2609

②APCSゾーン 東展示棟 Hall2 小間番号 2148

Webサイト : <https://www.semiconjapan.org/jp/>

SEMICON® JAPAN
APCS Advanced Packaging
and Chiplet Summit

出 展 品 目 : 芝浦メカトロニクス株式会社

■総合ゾーン（パネル展示）

枚葉式ウェーハ洗浄装置（SC300 series）
高温リン酸エッチング装置（SC300-HT series）
等方性エッチング装置（CDE series）
フォトマスクエッチング装置（ARES series）
フォトマスク洗浄装置（ARTS）
超高精度ハイブリッドボンダ（TFC-6700）
マルチプロセス高精度ボンダ（TFC-6500）
FO-PLP ボンダ（TFC-9300）
高精度ボンダ ラインナップ

■APCSゾーン（パネル展示）

Hybrid & fusion process ロードマップ&キーテクノロジー
超高精度ハイブリッドボンダ（TFC-6700）
2.5D, 3D & UHD FO-WLP ロードマップ&キーテクノロジー
マルチプロセス高精度ボンダ（TFC-6500）

芝浦エレテック株式会社

■総合ゾーン（実機・パネル展示）

モニタリングサービスツール キノシステム®
ガスフローコントローラ（GFC）
半導体製造装置用 部品の精密洗浄と再生

- 以上 -

【お問い合わせ先】

芝浦エレテック株式会社 経営企画部 企画担当

e-mail : sme_kikaku@shibaura.co.jp

web サイト : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>